证券代码：300782　　证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☑其他（电话会议）
参与单位名称	参会单位：（以下排名不分先后） 博时基金、招商基金、圆信永丰、华泰柏瑞、交银施罗德、申万菱信、民生加银、天风证券、中金公司、瑞银证券、国海证券、长城证券、山西证券、华创证券、国信证券、中原证券、招商证券、财通证券、中泰证券、中信证券、华福证券、汇丰前海证券、华泰证券、广发证券、美林国际、美林亚太、汇丰银行、汇丰环球资管（香港）、野村国际（香港）、摩根士丹利证券、摩根大通证券（亚太）、富瑞（Jefferies）、麦格理、建银国际、君和资本、嘉恒投资、睿郡资产、湘禾投资、银河投资、宁泉资产、哲云私募、亘曦私募、三花弘道、伯兄资产、耕霁投资、鑫融长弘、金蟾蜍投资、鸿竹资产、尚诚资产、国海创新资本、荣州聚享智研、鼎和私募、格林费尔、机缘投资、国华兴益资管、城金控股等
时间	2026年10月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰先生 董事会秘书：刘丽琼女士

投资者关系活动 **主要内容介绍**	一、简要介绍公司2026年前三季度整体情况 2026年前三季度，公司实现营业收入26.86亿元，同比下滑2.99%，归属于上市公司股东的净利润-7.68亿元，同比下降349.7%。 业绩承压主要来自两方面：一是AI驱动产业链供需与价格体系重构，压制下游智能手机景气度，并引致供需趋紧、原材料涨价与竞争加剧，叠加公司产品销售结构变化及供应转化的影响；二是Fab-Lite转型期产能投入较大，设备折旧逐年增加。需说明的是，折旧并非经营性亏损，而是前期战略性投入的财务反映，亦是公司将资本开支转化为长期竞争壁垒的主动选择。 从发展阶段来看，公司以芯卓的特色工艺平台为核心资产，以资产运营为经营逻辑，把工艺与设计的一体化能力，延伸到更多器件品类与应用领域。在此基础上，公司持续加强光通信与AI算力中心电源领域的能力建设。光通信方向，围绕AI高速光互联，推进12英寸SOI、SiGe等特色工艺，为自主可控光电芯片提供工艺支撑；电源方向，聚焦算力中心供电需求，开发差异化电源管理芯片，构建相应的产品与解决方案能力。上述领域均由欧美垄断，系国内高端芯片短板。公司依托芯卓产线及工艺储备推动突破，巩固射频主业、解决射频前端自主可控，并预研6G核心频段。通过“设计+工艺”协同等联合创新模式，形成“射频稳固+光电发展+算力电源配套”格局。 战略层面，公司明确两大核心平台：其一，卓越射频全栈平台，聚焦射频主业与高端模组规模化。以L-PAMiD模组为代表，已实现业界首款全国产自主供应链L-PAMiD量产，打破海外长期垄断，2026年起进入放量周期，在海外巨头退出中国市场、国产替代加速背景下，已在安卓手机市场快速抢占份额，有望成为全球市场有力竞争者。其二，湖光源启工艺平台，释放特色工艺能力，向新赛道延伸。依托该平台深度布局高速互联、高端模拟、电源管理等，一方面开辟光电第二增长曲线，打开长期空间；另一方面提供“工艺+设计+制造”一体化本土方案，夯实AI算力基础设施供应链安全。 市值管理层面，公司管理层持续关注资本市场波动与公司股价表现，重视股东回报。基于对公司自身价值的判断以及对未来发展前景的坚定信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用自有资金及/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来合适时机全部用于股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司激

	励体系，提升团队凝聚力与企业竞争力，推动公司健康可持续发展。 展望未来，公司将持续将资源投入自有产能建设，把工艺know-how、特色工艺平台搭建与供应链保障能力固化到资产端，形成难以复制的长期壁垒，加速新技术与新产品落地，推进规模化、平台化发展。 二、在问答环节，主要回复如下： **1、射频晶圆供应链正在发生变化，这会对公司形成什么影响？** A：尊敬的投资者，您好！公司高度关注供应链风险与结构变化。射频晶圆（特别是SOI、锗硅工艺）与光通信在产能上存在较强相关性，部分晶圆厂正将产能向光通信转移，导致射频相关产能供给趋紧。一旦这一趋势演变为较急迫的供需矛盾，公司自建产能的价值就会明显体现。目前，公司在下游多应用领域的供应地位保持稳固，并有机会在供应链波动中获得增量机会。感谢您的关注！ **2、请问公司百亿级资产对应每年8亿元以上的折旧，叠加持续研发投入，如何评价当前的经营质量与公司价值？** A：尊敬的投资者，您好！选择自建产能是公司六年前既定的战略路径，公司对此有充分预期：选择高端工艺路线，聚焦高性能产品的开发与交付，核心价值在于技术溢价。这一定位决定了产能规划优先服务于工艺能力；订单选择以产品价值为优先；研发投入的回收周期更长，但工艺壁垒长期难以复制、产能基础难以被淘汰。目前公司资产负债率约30.57%，经营活动产生的现金流量净额为正，财务结构稳健，具备持续投入能力。 长期看，公司目标是让特色工艺在算力中心光互联领域发挥核心价值，并在高端电源管理领域形成竞争力，力争向国际一流模拟与电源企业看齐。公司基于对自身价值的判断实施股份回购，也反映了管理层对长期发展的信心。感谢您的关注！ **3、请问公司毛利率的变动趋势及影响因素？** A：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司毛利率与净利润承压，主要受产能利用水平与产品结构阶段性变化的影响。在自建产能模式下，固定成本占比较高，产能爬坡期的成本分摊对毛利率形成压力，且相关影响在业务层面存在一定滞后性；上述波动属于产能建设与转型期的正常经营特征，并非经营性趋势恶化。公司将持续通过提升产能利用率、优化产品与客户结构、改善良率等方式，推动毛利率回归合理水平。感谢您的关注！

	4、请问展望明年，智能手机需求仍有压力，新产品与份额提升能否形成支撑？ A：尊敬的投资者，您好！公司业务与下游消费电子行业关联度较高，这是当前业务结构的客观特征。战略层面，公司依托特色工艺平台能力，由射频主业向 AI 相关的光互联、高端电源管理等新兴领域延伸。平台型公司的核心在于底层工艺能力可复用、可持续向新方向延展，光互联与电源管理是当前重点方向，并非边界。公司目标是形成以射频为根基、跨领域延展的平台型公司，构建相对稳定和可持续的增长结构，该过程仍需一定建设周期。公司将坚持既定技术路线，稳步推进各项业务落地。感谢您的关注！ **5、请问公司光互联相关产品目前进展如何？与国内同业相比有何差异？** A：尊敬的投资者，您好！光互联是公司重点投入的新方向。围绕AI高速光互联需求，公司依托12英寸产线SOI、锗硅等特色工艺，为自主可控的光电芯片提供工艺支撑，目前相关产品仍处于工艺稳定阶段，硅光芯片与电芯片方向均有产品在推进。 差异方面，公司采取“晶圆制造+设计”的工艺一体化路线，相较于依赖境外晶圆厂代工的同行业企业而言，公司在工艺自主可控与设计制造协同方面具备差异化能力。感谢您的关注！ **6、请问公司6G对公司主营业务的影响如何？6G与5G有何不同，高频频谱对射频器件与工艺会带来什么影响？** A：尊敬的投资者，您好！6G将使用更高频段与更大带宽，对射频前端的材料体系、器件结构与工艺能力提出更高要求，锗硅等高频高带宽技术的重要性将显著提升。公司在锗硅等特色工艺方向持续投入，是国内该领域投入体量与技术能力较为领先的企业之一。行业节奏方面，6G处于标准制定与技术探索阶段，公司已提前开展相关技术与产能准备。若6G产业化进程按预期推进，将对公司业务形成积极影响。感谢您的关注！ **7、请问公司在载板等上游供应链的紧张情况是否仍在影响射频模组出货？明年是否会有所缓解？** A：尊敬的投资者，您好！相较于上年第四季度与今年第一季度，供应链紧张程度已有所缓解，但整体仍处于偏紧状态。AI相关需求持续增长，客观上挤占与公司产品重叠的供应链产能，该情况对射频模组业务存在

	一定影响，预计明年仍将构成一定的持续性影响。公司将积极拓展多元化供应渠道，并科学地通过自有资源建设增强供应保障能力。感谢您的关注！ **8、关于公司在海外涉及专利侵权对公司经营有什么影响？** A：尊敬的投资者，您好！关于专利诉讼事项，公司已披露与村田（Murata）在德国慕尼黑第一地方法院两起专利诉讼的一审判决情况。该判决为一审判决，案件尚未终结，公司有权在法定期限内提起上诉，并已通过专利无效等法律程序积极维护公司及全体股东的合法权益。涉案范围仅涉及单一客户的单一型号产品，预计不会对公司2026年营业收入产生影响，亦不会对公司整体经营财务状况、持续经营能力及与客户的正常合作产生实质性影响。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026年10月30日